



<b>Title of Change:</b>	AUK-Korea develop 2 <sup>nd</sup> lead frame raw material supplier for SOT-563F.	
<b>Proposed First Ship date:</b>	2 September 2020	
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> >.	
<b>Samples:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <a href="mailto:PCN.Samples@onsemi.com">PCN.Samples@onsemi.com</a> > Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
<b>Type of Notification:</b>	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> >	
<b>Change Part Identification:</b>	Product with date code 2040 or newer will be assembled with new raw material lead frame from new lead frame supplier	
<b>Change Category:</b>	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
<b>Change Sub-Category(s):</b>	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input checked="" type="checkbox"/> Other: <u>Lead Frame Supplier Change</u>	
<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: NONE	External Foundry/Subcon Sites: AUK-KOREA
<b>Description and Purpose:</b>		
ON Semiconductor would like to inform its customers of a change in the lead frame supplier for the OPN listed in this IPCN. This change is a result of the existing lead frame supplier KOBE has lead frame supply disruption issue which causing production line down. The replacement lead frame supplier is SH Copper (Pre.Hitachi).		
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>
<b>Lead frame raw material supplier</b>	KOBE	SH COPPER (PRE.HITACHI)
<b>Lead frame material</b>	7MELF3410 (Lead frame SOT563 6L CAC92 Ag 6X50 STAMPED)	7MELF3410 (Lead frame SOT563 6L HCL305(1/2H) Ag 6X50 STAMPED)
The reliability test qualifications will estimate to complete on WW35'20.  There is no product marking change as a result of this change.		



**Qualification Plan:**

**QV DEVICE NAME : 2N7002VA**

**PACKAGE: SOT-563F**

Test	Specification	Condition	Interval
HTSL	JESD22-A103	Ta=max rate temp storage	1008 hrs
PC	JSTD 020, JESD-A113	IR reflow at 260C	
THB	JESD22-A101	Temp=85C, RH=85%, bias=100%of rated V or 100V max	1008 hrs
TC	JESD-A104	Temp=-55C to +150C	1000 cyc
AC	JESD22-A102	121°C/100% RH/15 PSIG	96 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C Ton=Toff at 2 mins	15000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 28 August 2020

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FDY6342L	2N7002VA
FDY2000PZ	2N7002VA
FDY4000CZ	2N7002VA
FDY1002PZ	2N7002VA
FDY3000NZ	2N7002VA
2N7002V	2N7002VA
2N7002VA	2N7002VA

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22805X

発行日 : 15 August 2019

変更件名:	AUK-Korea における SOT-563F 用 リードフレーム原材料の第 2 サプライヤの開拓										
初回出荷予定日:	2 September 2020										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。										
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。										
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。										
変更部品の識別:	日付コード 2040 以降の製品は、新しいリードフレームサプライヤによる新しい原材料 リードフレーム で組み立てられます。										
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____										
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他: <u>リードフレームサプライヤ変更</u>										
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: AUK-KOREA									
説明および目的:	<p>オン・セミコンダクターは、本 IPCN に列記された OPN の リードフレームサプライヤの変更をお客様にお知らせいたします。この変更は、既存のリードフレーム サプライヤである KOBE に リードフレーム供給停止の問題が発生し、生産ラインが停止していることによるものです。代替 リードフレームサプライヤは SH Copper (以前の日立) です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リードフレーム原材料サプライヤ</td> <td>KOBE</td> <td>SH COPPER (PRE.HITACHI)</td> </tr> <tr> <td>リードフレーム 材料</td> <td>7MELF3410 (リードフレーム SOT563 6L CAC92 Ag 6X50 ス タンブ)</td> <td>7MELF3410 (リードフレーム SOT563 6L HCL305(1/2H) Ag 6X50 スタンブ)</td> </tr> </tbody> </table> <p>信頼性認定試験は 2020 年 WW35 に完了する見込みです。</p> <p>今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。</p>			変更前の表記	変更後の表記	リードフレーム原材料サプライヤ	KOBE	SH COPPER (PRE.HITACHI)	リードフレーム 材料	7MELF3410 (リードフレーム SOT563 6L CAC92 Ag 6X50 ス タンブ)	7MELF3410 (リードフレーム SOT563 6L HCL305(1/2H) Ag 6X50 スタンブ)
	変更前の表記	変更後の表記									
リードフレーム原材料サプライヤ	KOBE	SH COPPER (PRE.HITACHI)									
リードフレーム 材料	7MELF3410 (リードフレーム SOT563 6L CAC92 Ag 6X50 ス タンブ)	7MELF3410 (リードフレーム SOT563 6L HCL305(1/2H) Ag 6X50 スタンブ)									



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22805X

発行日 : 15 August 2019

## 認定計画:

デバイス名: 2N7002VA

パッケージ: SOT-563F

テスト	仕様	条件	間隔
HTSL	JESD22-A103	Ta=max rate temp storage	1008 hrs
PC	JSTD 020, JESD-A113	IR reflow at 260C	
THB	JESD22-A101	Temp=85C, RH=85%, bias=100%of rated V or 100V max	1008 hrs
TC	JESD-A104	Temp=-55C to +150C	1000 cyc
AC	JESD22-A102	121°C/100% RH/15 PSIG	96 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C Ton=Toff at 2 mins	15000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	

認定完了予定日 : 28 August 2020

## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FDY6342L	2N7002VA
FDY2000PZ	2N7002VA
FDY4000CZ	2N7002VA
FDY1002PZ	2N7002VA
FDY3000NZ	2N7002VA
2N7002V	2N7002VA
2N7002VA	2N7002VA